

证券代码：688141

证券简称：杰华特

杰华特微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-005

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	鑫元基金、前海开源基金、璞林资本、鹏华基金、国信证券、国盛证券、景顺长城基金、浙商证券、中邮证券、南方基金、平安养老、中信证券等（排名不分先后）
时间	2025 年 8 月 4 日-2025 年 8 月 8 日
地点	现场会议、线上交流
上市公司接待人员姓名	总经理、董事会秘书：马问问 市场和系统总监：李正兴
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司 2025 年第一季度情况介绍： 2025 年第一季度，公司实现营业收入 52,814.63 万元，实现同比环比双增长，其中同比增长 60.42%。一季度毛利率 29.69%，较 2024 年同比提升 2.01 个百分点。公司归属于母公司所有者的净利润-11,340.76 万元，同比减亏。公司于 2025 年第一季度，经营活动产生的现金流量净额由负转正。 二、投资者交流问答环节 公司主要就以下方面内容与投资者进行了沟通： 问题一：请问公司目前申请港股上市的进度情况？ 公司已于 2025 年 5 月 30 日向香港联合交易所有限公司递交了 H 股上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。目前相关工作有序推进中，进展请关注公司公开

	披露的相关信息。 问题二：公司产品会涨价吗？ 公司会持续监控行业跟涨动向，并已建立了多维度的价格管理机制应对市场变化，同时公司会协助客户优化设计方案对冲成本上升。 问题三：公司在新能源领域、网通和安防领域、汽车电子领域以及计算领域有哪些的技术布局？ 1、新能源领域，公司推出了基于自有工艺的超高压面向太阳能应用的 PMIC(电源管理集成电路)芯片，具有系统级时序管理功能，集成度高，易于使用，已通过客户的测试。 2、网通和安防领域，公司推出了多款 PoE 以太网供电芯片，包括高集成 4 路 PSE 供电芯片、高性价比 8 路 PSE 供电芯片、PD 受电端协议和功率全集成芯片，部分产品已在多家头部客户通过测试并进入小批量供货阶段。 3、汽车电子领域，公司推出了多款汽车应用的高低边驱动芯片和车灯驱动芯片，已进入客户设计阶段；推出了新一代车规 DrMOS 并实现量产，公司推出了多款 USB 车充和协议芯片，已经开始收获订单，获得了客户的认可；公司在报告期内基本完成了汽车 LDO 的布局，能够提供完整的 LDO 产品组合。 4、计算领域，公司推出了符合 intel.VR14 的 12 相控制器、intel.IMVP9.3 的 9 相控制器等多款多相控制器和 DrMOS 大电流产品，获得了计算行业客户的高度好评，推出了多款业界领先水平功率管集成产品，包括 18V/25A、18V/50A 等, 具有导通功耗小、启动电流能力大、恶劣情况下保护性能强等优点，获得了计算领域客户的广泛认可。 公司通过多样化的产品线、技术创新和客户价值提升，
--	---

	可以有效应对市场变化，抓住新兴机会，实现长期可持续发展。 问题四：公司近期收购的天易合芯对公司有什么正面影响？ 1、公司一直围绕平台化策略布局产品，天易合芯的光学传感芯片、电容传感芯片（SAR 传感芯片）等产品能够与公司产品线高度互补，可以扩大公司信号链品类的产品布局。其传感器产品技术可以和公司现有核心技术有效融合，可助力公司拓展更多的高性能信号链产品。2、天易合芯的产品已导入多家头部手机厂商，公司收购天易合芯可以更好的满足客户对于供应商产品品类完备性的需求，公司可以借助天易合芯的手机客户渠道，将公司的其他电源管理等产品导入手机客户，进一步提升市场竞争力和市场份额。3、2025 年第一季度，天易合芯实现营业收入 5,004.17 万元，净利润 150.35 万元，成功实现盈利。对全年业绩形成了良好的开局支撑，同时对上市公司的业绩起到了正向的叠加作用。 问题五：请问公司今年的存货减值如何展望？ 公司第一季度主营业务收入 52,814.63 万元，下游部分细分领域需求呈现企稳回升态势。一季度存货减值约 2,500 万元，同比大幅降低。公司将通过细化预测粒度至特定产品及客户来提高市场需求预测的准确性，以便更精确地调整生产计划与预计销量。同时，在充分考虑产品交货周期、客户需求及市场状况后，我们亦计划强化库存管理措施，以维持安全库存水平，有效缓解客户需求波动，降低存货减值亏损对公司财务状况的影响。 问题六：公司层面预计何时能够实现扭亏为盈，如何保证经
--	---

	营的稳定？ 2025 年第一季度，公司归属于母公司所有者的净利润-11,340.76 万元，已实现同比大幅减亏。公司当前正处于战略性投入阶段，整体经营情况保持稳定。目前，公司正持续进行技术迭代，进一步优化产品性能与成本结构；深化市场开拓，重点突破行业头部客户，提升高附加值产品占比；通过规模效应和产品升级持续改善利润率水平，确保公司始终处于良性发展轨道。 问题七：代工厂方面目前看到产能的变化情况吗？成本的变化情况如何？ 目前半导体供应链呈现结构性调整态势，部分晶圆厂和封装厂产能出现了趋紧的情况。公司在供应链管理方面制定了明确的战略规划，会根据市场大环境的变化及时做出调整。当前，公司在产能分配上能够合理匹配业务订单需求,也获得主要上游供应商的大力支持。目前，公司晶圆采购及封测环节的成本维持在稳定区间，未来将持续优化供应链结构，巩固虚拟 IDM 模式的竞争优势。
附件清单（如有）	无
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息
日期	2025 年 8 月 12 日